

VERBALE DI GARA APERTURA BUSTA “DOCUMENTAZIONE”

per l'affidamento del servizio di interconnessione tramite flip-chip bump bonding del chip di readout e del sensore per l'esperimento PixFEL (Lotto A) e per l'upgrade di Fase II del rivelatore a pixel di CMS nell'ambito dell'esperimento RDFASE2 (Lotto B), Riferimento Atto G.E. n.11204 del 16/11/2016

Il giorno 16 febbraio alle ore 10:05 presso i locali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Pisa largo B.Pontecorvo 3 edificio C, 56127 PISA (PI), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ho proceduto alla apertura delle buste amministrative relative alla gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di interconnessione tramite flip-chip bump bonding del chip di readout e del sensore per l'esperimento PixFEL (Lotto A - CIG: **ZBC1C25EF8**) e per l'upgrade di Fase II del rivelatore a pixel di CMS nell'ambito dell'esperimento RDFASE2 (Lotto B - CIG: **6879624D4F**).

Si prende atto che entro la data di scadenza del bando, fissata alle ore 16:00 del 1/2/2017 risulta regolarmente pervenuta n.1 (una) offerta.

L'offerta pervenuta e' la seguente:

Fraunhofer IZM - Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 – Berlin, Germany

Non e' presente nessun rappresentante della ditta partecipante.

Si procede all'apertura dei plichi pervenuti.

Le due offerte presentate, rispettivamente del Lotto A e del Lotto B, sono regolarmente contenute ciascuna in un plico sigillato e siglato, e contengono rispettivamente una busta sigillata contenente l'offerta tecnica, una busta sigillata contenente l'offerta economica e la relativa documentazione amministrativa.

Dall'analisi della documentazione amministrativa inclusa in ciascuno dei due lotti emerge quanto segue:

tutta la documentazione richiesta nel bando risulta presente e valida, pertanto la ditta e' ammessa e si consegna al Presidente della Commissione tutta la documentazione.

Pisa 16/2/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Roberto Dell'Orso

